中信证券股份有限公司

关于深圳清溢光电股份有限公司

2025 半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“清溢光电”或“公司”或“上市公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账；

（5）对公司高级管理人员进行访谈；

（6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

（7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

（8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与公司相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、公司产品和技术在国际市场上的竞争力并不领先的风险

国内的掩膜版产业相比国际竞争对手起步较晚，经过二十余年的努力追赶，国内掩膜版产品与国际竞争对手在新品推出的时间差距逐步缩短、产品性能上差距逐步缩小。国内市场对掩膜版的需求较大，公司产品在国内中高端掩膜版市场的占有率较低，明显低于国际竞争对手。公司作为国内规模最大、技术领先的掩膜版厂商之一，在新的产品取得重大突破以及通过下游客户认证后，可能遭遇国际竞争对手的刻意价格竞争。因国内掩膜版产业起步晚、公司规模相对国际竞争对手偏小、技术沉淀相对国际竞争对手较弱等因素，公司存在现阶段的产品和技术在国际市场上的竞争力并不领先的风险。

（二）经营风险

1、主要设备和原材料均依赖进口的风险

公司主要原材料为掩膜版基板，且主要由境外供应商提供。公司主要生产设备光刻机均向境外供应商采购，且供应商集中度较高，主要为瑞典 Mycronic、德国海德堡仪器两家公司，其中最高端的平板显示用光刻机由瑞典 Mycronic 生产，全球主要掩膜版制造商对其生产的设备都存在较高程度依赖。公司存在主要设备和原材料均依赖进口的风险。未来，如果公司的重要原材料、主要设备与备件发生供应短缺、价格大幅上涨，或者供应商所处的国家和地区与中国发生贸易摩擦、外交冲突等进而影响到原材料、主要设备与备件的出口许可，将会对公司

生产经营产生不利的影响。

2、产品质量控制的风险

公司主要产品掩膜版是下游电子元器件行业生产制造过程中的核心模具，是下游产品精度和质量的决定因素之一。公司根据与客户签订的销售合同/订单，向客户提供符合其品质指标要求的产品，如果未来公司出现重大产品质量事故，将可能面临客户根据销售合同约定要求公司给予相应赔偿或中断与公司业务合作的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

3、重资产经营的风险

公司所处掩膜版行业为资本密集型行业，主要生产设备昂贵，固定成本投入较大，存在重资产经营的风险。随着公司经营规模扩大和产品结构升级，公司积极对生产线进行改造升级，目前公司固定资产使用情况良好，核心生产设备产能利用率较高，但未来如果出现下游客户需求大幅减少，公司销量大幅降低的情形，将可能导致公司产能过剩的风险，则新增固定资产折旧也将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

4、主要客户相对集中的风险

公司向前五大客户销售金额较高，销售客户相对集中。如果未来公司主要客户经营状况出现不利变化或主要客户对公司产品需求下降，将可能对公司业务经营和盈利能力造成不利影响。

（三）盈利能力下滑的风险

掩膜版行业特点属重资产经营，佛山生产基地项目建设投资较大，未来公司工厂厂房、设备折旧等固定成本增加。若行业竞争程度进一步加剧、受宏观经济影响导致下游市场需求出现下滑、原材料价格波动、高端产品开发及客户认证不达预期、公司未能进一步提升竞争优势、产能利用率未能提升到较高水平，则公司存在盈利能力持续下滑的风险。

（四）行业风险

1、市场竞争加剧的风险

近年来随着平板显示和半导体产业的快速发展，掩膜版市场需求旺盛。目前行业内竞争对手主要有美国的福尼克斯、日本的 TOPPAN、SKE、HOYA、DNP、韩国的 LG-IT、中国台湾的台湾光罩和中国大陆的掩膜版企业，行业集中程度较高。随着下游产业向中国大陆不断转移，未来将导致市场竞争加剧，对公司的经营业绩产生一定的影响。

2、下游平板显示行业发展变化的风险

平板显示掩膜版对公司报告期内经营业绩的影响较大。平板显示行业对掩膜版的需求量主要受到其研发活动活跃度、新产品开发数量、下游产品迭代周期、液晶面板产线数量、终端电子产品的市场需求等因素的影响，若下游平板显示行业发展发生不利变化，从而导致其对平板显示掩膜版的需求量减少，将会对公司的业绩产生不利影响。

3、下游产业结构调整风险

公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控以及电路板行业，目前上述行业在全球范围内呈快速发展态势，且有加快向中国大陆转移的趋势。随着消费电子产品技术革新、消费者偏好及市场热点的变化，公司下游产业可能出现结构性调整，各细分行业市场对掩膜版的需求结构可能发生较大变化，如果公司不能迅速觉察并调整产品思路以适应该等变化，将会对公司的业绩以及长远发展产生一定的不利影响。

4、技术替代的风险

目前全球范围内平板显示、半导体、触控等行业基本都采用掩膜版作为基准图案进行曝光复制量产，无掩膜光刻技术精度低，主要用于电路板行业。掩膜版光刻制作技术通常分为激光直写法和电子束直写法。激光直写法使用波长为 193nm、248nm、365nm、413nm 等的连续或脉冲激光光源，整形精缩成为 200~500nm 的激光点在掩膜光刻胶上画出电路图案后，通过显影蚀刻获得电路图案；电子束直写法使用小至纳米级的电子束斑为笔，在掩膜光刻胶上画出电路图案，掩膜版上的电子束胶在曝光显影后，通过湿法或干法蚀刻获得电路图形。公司目前主要采用激光直写法生产掩膜版，随着科学研究的进步，不排除掩膜版行

业会出现新的无掩膜光刻技术对原有的工艺技术形成替代，从而产生技术替代风险。

（五）宏观环境风险

1、宏观经济波动带来的风险

掩膜版主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具，下游领域的发展情况较大程度上影响到掩膜版产品的供求变化。近年来，中国掩膜版行业受益于下游应用领域的良好发展态势，保持了一定的增长，而下游领域的发展态势与国内外宏观经济形势息息相关。全球宏观经济的波动风险，将可能对公司的生产经营造成不利影响。

2、美国芯片和科学法案带来的风险

美国针对中国半导体产业的发展采取了技术出口管制、禁售高端光刻机和软硬件配套设施、向中国科技企业施加“芯片禁令”及组织“芯片联盟”等措施，体现出了美国对中国半导体产业的管制，以达到阻碍和延缓中国半导体产业在“先进制程”上升级的步伐，相关措施对中国半导体产业的发展带来了诸多不确定性，可能对公司半导体芯片掩膜版的技术升级、设备引进、材料进口和市场开发带来不确定性风险，将可能对公司的生产经营造成不利影响。

3、主要原材料出口国（地区）和主要产品进口国（地区）政策调整风险

公司掩膜版产品的主要原材料掩膜版基板的境外供应商集中在日本、韩国和中国台湾。若未来上述国家或地区为保护其本国或地区相关行业的发展，限制掩膜版基板的出口或制造贸易摩擦，将可能对公司的生产经营造成不利影响。

公司的掩膜版产品部分出口，主要销往中国台湾、新加坡。若未来上述国家或地区为保护其本国或地区相关行业的发展，调整掩膜版产品进口政策，将可能对公司掩膜版产品销售造成不利影响。

4、环境保护的风险

公司生产经营中产生废液、废水、废气等环境污染物，报告期内，公司不存在因违反环境保护相关法律、法规而受到重大处罚的情形。未来随着国家环境保

护政策进一步完善，环保标准亦可能逐步提高，如果公司无法达到相应的环保要求或出现重大环保事故，将可能产生因违反环境保护法律、法规而受到相关部门处罚的风险，对公司生产经营造成不利影响。

5、停电的潜在风险

国内外宏观经济、燃料供应、气温和降水等多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。未来如果出现大面积限电或停电情况，可能存在导致工厂停产的风险，对公司的生产运营造成影响。

6、深圳高新区北区旧改重建带来的风险

深圳工厂位于深圳市高新区北区，周边的写字楼及工厂在进行旧改重建。深圳工厂的光刻机及配套设备对振动有要求，旧改重建产生的振动给光刻机安全生产带来不确定性。未来如果出现振动超标情况，可能存在导致光刻机停产或产品报废的风险，对深圳工厂的生产运营造成影响。

7、日元汇率波动带来的风险

1）原材料采购绝大部分以日元计价，如汇率大幅波动会导致成本的大幅波动。

2）日韩竞争对手产品以日元计价，如汇率大幅波动可能会导致竞争力减弱。

8、关税政策带来的风险

美国对中国商品加征关税（包括部分半导体相关产品）对中国掩膜版企业带来了短期成本上升、供应链调整重构、出口市场受限的风险。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减（%）

营业收入	62,203.02	56,089.49	10.90
归属于上市公司股东的净利润	9,203.76	8,890.77	3.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,289.50	8,074.64	2.66
经营活动产生的现金流量净额	15,161.66	13,073.85	15.97
主要会计数据	**2025 年 6 月末**	**2024 年末**	**本期末比上年同期末增减（%）**
归属于上市公司股东的净资产	270,903.08	148,320.67	82.65
总资产	390,270.12	274,276.75	42.29
主要财务指标	**2025 年 1-6 月**	**2024 年 1-6 月**	**本期比上年同期增减（%）**
基本每股收益（元 / 股）	0.29	0.33	-12.12
稀释每股收益（元 / 股）	0.29	0.33	-12.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.26	0.30	-13.33
加权平均净资产收益率（%）	4.79	6.30	减少1.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.31	5.72	减少1.41个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	4.00	4.54	减少0.54个百分点

归属于上市公司股东的净资产和总资产较上年末分别增长 82.65%和 42.29%，主要系本期向特定对象发行股份人民币普通股股票 4,800.00 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 120,000.00 万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为 118,700.94 万元。

本期归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度较小，主要系本期财务费用（汇兑损失及利息支出）大幅增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

掩膜版行业竞争激烈，大多数客户都有多家掩膜版供应商。公司的竞争能力主要来源于公司通过先进技术生产高质量的产品、提供及时的交货期、有竞争力的价格和快速响应的服务，这是客户选择公司作为掩膜版供应商的主要因素。

1、拥有自主创新的技术开发实力，先进的工艺技术水平

公司是国家高新技术企业，以现有研发中心为依托，在已成立的深圳市光掩膜研发中心基础上成立“广东省光掩膜工程技术研究开发中心”，公司拥有从设计、工艺到产品整套流程的技术开发实力，是《薄膜晶体管（TFT）用掩模版规范》行业标准起草单位。2016 年 10 月成功研制 AMOLED 用高精度掩膜版，成为全球具备 AMOLED 用高精度掩膜版生产能力的厂家之一，打破了国内 AMOLED 用高精度掩膜版完全依赖国外进口的局面，已经正式给多家国内面板企业供货。公司 8 代 TFT LCD 掩膜版产品在 2019 年获得深圳市科技进步二等奖。合肥清溢成立了光掩膜技术研发中心，主要从事高精度掩膜版产品的研发工作，获批 2023 年度合肥市认定企业技术中心。2022 年合肥清溢承担完成了国家基础产业再造和制造业高质量发展专项--8.5 代及以下高精度掩膜版项目。合肥清溢 2024 年针对客户需求实现了中高端半透膜掩膜版（HTM）产品的研发和量产，2025 年上半年实现了超高规半透膜掩膜版（HTM）的研发与小规模量产。

除产品研发外，公司在精密设备研发方面也具有技术先进性，公司设有专门的设备研发中心，通过多年的技术积累，逐步形成了测量、修补、贴膜等设备的制作及维护能力，大大降低了生产成本，形成了独有的竞争优势。

此外，公司具备先进的图形设计及工艺处理能力。公司采用行业顶尖的设计软件，并结合公司多年生产积累的经验及客户需求对上述软件进行二次开发，增强了上述软件对掩膜版行业的适用性，提高了应用效率,可对产品工艺参数进行设计规则检查和图形元素符合性检查，自动进行图形逻辑处理、优化及对比检查，极大地提高了产品工艺质量。

2、国内领先的规模优势，产品矩阵不断丰富

公司作为国内规模最大的掩膜版产品和服务提供商之一，具备各类掩膜版产品设计、研发、制造与销售能力，拥有优质多样的掩膜版产品线，产品主要涉及平板显示和半导体产业，涵盖了平板显示、触控、柔性电路、集成电路凸块（IC Bumping）、集成电路代工（IC Foundry）、集成电路载板（IC Substrate）、MicroLED 芯片、微机电（MEMS）等领域掩膜版，凭借自主创新的技术研发实力、订单的快速响应速度、丰富优质的产品及服务来满足客户需求。

为适应国内平板显示行业的快速发展，凭借公司多年技术积累和成熟的生产工艺，公司聚焦于扩大中高端平板显示掩膜版的产能，加大研发投入，为公司产品结构向中高端平板显示掩膜版渗透奠定基础。

在平板显示掩膜版技术方面，已实现 8.6 代高精度 TFT 用掩膜版、6 代中高精度 AMOLED/LTPS 等掩膜版，以及中高端半透膜掩膜版（HTM）产品的量产，规划增加产线，用于扩大 AMOLED、HTM 用掩膜版的产能，同时新增 PSM 掩膜版的生产能力，将扩大 AMOLED、AR/VR 等高端掩膜版的产能，加快公司以 HTM、OPC、PSM 等技术为代表的新产品、新工艺的研发及量产，填补 PSM 产品的技术空白，逐步实现高端掩膜版的国产替代，更有利于公司的长远发展。

半导体芯片掩膜版技术方面，公司已成功实现 180nm 工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，并完成了 150nm 工艺节点掩膜版的小规模量产。此外，公司正在积极推进 130nm 至 65nm 工艺节点的 PSM（相移掩膜）和 OPC（光学邻近校正）掩膜版开发，并已着手规划 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发。在半导体芯片领域，公司已开发了芯联集成、中车时代、比亚迪半导体、三安光电、长电科技、通富微电、艾克尔、士兰微、泰科天润、积塔半导体、捷捷微电、斯达半导体和赛微电子等客户。优质的客户保障了公司经营的稳定性，并给予公司充分的发展空间。

公司坚持“技术创新驱动”战略，通过持续拓展半导体芯片的先进工艺研发能力和先进产品的竞争力，提升半导体芯片掩膜版的国产化率，实现自主可控。

3、利用区域优势，为国内客户提供更贴身、更周到、更及时的服务

由于下游客户对掩膜版的交期、响应速度和服务要求较高，所以掩膜版行业有一定的区域性特征，公司拥有合肥和深圳两个生产基地，佛山生产基地正在建设中，就近配套下游客户有一定的优势。在产品趋向大尺寸和高精度情况下，掩膜版的包装运输难度增加，运输距离的远近成为影响交货期和服务质量的关键因素。与国际竞争对手相比，公司在产品交付中具有运距短、运输便捷的优势，有利于公司提高对国内客户的快速反应能力，能够为客户提供更贴身、更周到、更及时的服务。

此外，在客户后续使用产品的过程中，常常伴随着返清洗、返修、补贴膜等需求，公司本地化的服务能够更好的贴近客户的各种需求。

合肥和佛山工厂拥有更高精度的生产及检测等工艺设备，更智能的无人净化车间。随着合肥工厂的扩产及佛山工厂的量产，将提高产业链的国产化率，驱动国内掩膜版高端制造业，为更好地服务客户奠定基础。

4、良好的行业口碑及优质的客户资源，积累了大批知名客户

公司主要客户均为平板显示产业、半导体芯片产业的知名企业，公司作为国内规模最大的掩膜版专业产品和服务提供商之一，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。公司通过优质产品和服务在行业内树立了良好的口碑，通过多年的积累，公司与下游知名企业建立了良好的合作关系，且合作产品范围不断丰富，在平板显示领域，公司拥有京东方、维信诺、惠科、天马、华星光电、信利、龙腾光电、群创光电、华佳彩等客户；在半导体芯片领域，公司已开发了芯联集成、中车时代、比亚迪半导体、三安光电、长电科技、通富微电、艾克尔、士兰微、泰科天润、积塔半导体、捷捷微电、斯达半导体和赛微电子等客户。优质的客户保障了公司经营的稳定性，并给予公司充分的发展空间。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	变化幅度（%）
费用化研发投入	2,485.03	2,548.28	-2.48
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	2,485.03	2,548.28	-2.48
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.00	4.54	减少 0.54 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

公司研发支出不存在显著变化。

（二）研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	LMM150 型 CD 测量机研发项目	400.00	142.56	363.69	项目验收阶段	9 英寸及以下高精度掩膜版 CD 测量：最小测量线缝宽度：0.5μm；线缝重复精度 3σ：150×物镜倍率达到 3nm。	核心技术突破	已应用于生产
2	4.5GHTMCFMASK（PS 层）产品开发项目	500.00	73.07	467.01	项目验收阶段	1）VPG1400B 二次对位曝光技术；2）HTM 清洗技术；3）51MD 或 XET-200HTM 检验方法。	核心技术突破	已应用于生产
3	大尺寸 MASK 上下版转运台车	400.00	19.30	201.76	项目验收阶段	1）兼容 MASK 尺寸规格：800*920-1400*1650，兼容 Loader:光刻、显影、蚀刻、清洗、AOI、CD 机等；2）实现 6 个方向自由度可调，类似半自动 AGV 小车功能。	制造工艺改良	应用于生产
4	4 次*4 套合曝光大尺寸异形硅片 MASK 制作	400.00	271.88	271.88	工艺开发阶段	1）技术目标：居中精度≤1.5mm；套合精度≤±0.5mm。2）光刻机增加多次套合曝光功能。3）异形版材制作测试，确定各操作工序和参数。4）居中精度、套合要求达到客户指标。	核心技术突破	应用于生产
5	G6 及以下 MASK 两轴多角度翻转 Mura 检查&装盒治具架	500.00	345.71	345.71	生产测试阶段	1）技术目标：MASK 外观检查用可升降、多角度检版架；920mm≤尺寸≤1200mm 订单直立装盒架。2）原材料边缘光刻胶处理操作更方便和规范。3）脱膜后 CD、TP 测量工序在对应设备上实现 jig 抬版、上版、装盒操作。4）减少人员操作中活动导致的 MASK 外观污染及版边污染。	核心技术突破	应用于生产

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
6	MARK 自动检测	150.00	29.58	29.58	程序编写与测试阶段	1）根据 Tooling 中客户提供的坐标值，自动检测 MARK 的尺寸及正负效果。2）实现程序自动检测，减少人工检查的时间及漏检。	软件技术改良	应用于生产
7	提高下单最小线缝的准确性	150.00	35.32	35.32	测试验证阶段	1）实现程序自动标识出指定范围的线缝。2）建立各客户非有效最小线缝图形的标准。3）系统增加“图形线缝”字段，录入有效最小线缝。4）更新图标距值边为设计后的图形距边值。	软件技术改良	应用于生产
8	MetalMask 设计	200.00	101.25	101.25	测试验证阶段	1）实现各种类型 slot 的不同阵列方式快速自动阵列。2）实现通过不同图形颜色检查渐进式 slot 阵列效果。3）通过 excel 实现自动计算 DC 补偿数据表。4）实现 AutoCAD 中 slot 图形自动 DC 补偿。5）满足 8.5GMetalMask 设计要求，设计处理时间控制在 24 小时内完成。	软件技术改良	应用于生产
9	涂胶线增加 98155 尺寸改造项目	300.00	101.25	336.40	已完成	涂胶工序新增生产 98155 尺寸能力。	核心技术突破	应用于生产
10	清洗机 2#98115 产品少铬图层出货清洗膜面 Particle 改善工艺项目	400.00	115.24	328.54	中试少铬图层出货清洗膜面 Particle 改善	改善后，下料检查良率达 99%以上。	核心技术突破	应用于生产
11	光刻机激光器监控系统搭建	500.00	145.14	145.14	中试光刻机激光器监控系统搭建	建立激光器监控系统，生成异常临时处理措施手册。	核心技术突破	应用于生产

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
12	光刻机平台坐标系统合并及生产导入	400.00	126.72	126.72	整合完善光刻机坐标系统，正在逐步生产导入中	整合完善光刻机坐标系统，正在逐步生产导入中。	核心技术突破	应用于生产
13	基于多重光刻技术下的线缝精度(CD)均一性优化	300.00	116.86	116.86	中试多重光刻技术下的线缝精度(CD)均一性优化	中试多重光刻技术下的线缝精度(CD)均一性优化。	核心技术突破	应用于生产
14	新型蚀刻液研究项目	50.00	24.71	24.71	中试新型蚀刻液，改善生产	在不影响蚀刻速率情况下优化解决蚀刻参数。	制造工艺改良	应用于生产
15	机器人效率提升	100.00	77.38	77.38	已完成	机器人取放板速度提升 15%以上。	制造工艺改良	应用于生产
16	涂胶线 5280&7080 治具研发项目	150.00	154.24	154.24	已完成	研发涂胶线 5280&7080 治具，满足使用条件。	制造工艺改良	应用于生产
17	Cr 系-PSM 蚀刻工艺抓取项目	300.00	24.00	24.00	初试 Cr 系-PSM 蚀刻工艺	完成 Cr 系-PSM 蚀刻工艺准备。	核心技术突破	应用于生产
18	应用于 IC 掩膜版复杂图形 Bias 的软件开发	150.00	56.62	151.14	项目验收阶段	实现 ICFoundry 复杂图形添加不同 Bias 的功能	制造工艺改良	应用于生产
19	手工脱膜线工艺能力提升	60.00	3.06	64.24	已完成	改善手工线的脱膜方法，掌握高精度小版的脱膜工艺	制造工艺改良	应用于生产

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
20	150nmBIM 掩膜工艺开发	150.00	59.28	150.54	已完成	1>CD：Tolerance（±25nm）、MTT（±25nm）、CDU（≤25nm）2>Registration：±25nm3>Defect：0.25um	核心技术突破	应用于生产
21	应用于 IC 掩膜版 toolingForm 数据自动转换的软件开发	80.00	27.52	80.27	项目验收阶段	实现 ICtoolingForm 数据的自动转换	制造工艺改良	应用于生产
22	应用于 IC 掩膜版光刻参数自动转换的软件开发	80.00	34.80	78.92	项目验收阶段	实现 IC 光刻参数自动转换	制造工艺改良	应用于生产
23	基于 CATS 的 ICF 图形程序开发	150.00	88.80	88.80	完成软件开发	在 Cats 软件实现 ICFoundry 掩膜设计	软件技术改良	应用于生产
24	基于 130nmIC 掩膜版缺陷检查能力提升	250.00	157.60	157.60	项目验收阶段	130nmIC 掩膜版缺陷检查能力提升	核心技术突破	应用于生产
25	130nmPSM 工艺研发	250.00	42.46	42.46	工艺开发阶段	1、PhaseAngle：180 度±3 度 2、Transmittanceat248nm：6%±0.3%3、CD（onmask）：≤0.52um4、C.D.Tolerance：±0.02um	核心技术突破	应用于生产
26	应用于 IC 掩膜版的 OPC 补偿技术开发	150.00	13.07	13.07	软件设计阶段	1、Line-endToLine-end 的 Hammerhead-OPC 的实现 2、Line-endToLine 的 Hammerhead-OPC 的实现	软件技术改良	应用于生产
27	LCVD250 修补机研发项目	250.00	6.85	6.85	设备研发阶段	1、实现缺陷尺寸≥2u 补的能力 2、实现缺陷尺寸≥0.7u 修的能力	核心技术突破	应用于生产
合计	/	**6,770.00**	**2,394.27**	**3,984.08**	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

姓名	身份/职务	期初直接持股数（股）	期末直接持股数（股）	期间内股份增减变动量	增减变动原因
光膜（香港）有限公司	控股股东	73,977,300	73,977,300	0	/
唐英年	实际控制人	0	0	0	/
唐英敏	实际控制人	0	0	0	/
	董事				
	董事长				
唐庆年	董事	0	0	0	/
唐嘉盛	董事	0	0	0	/
张百哲	董事	0	0	0	/
	副董事长				

姓名	身份/职务	期初直接持股数（股）	期末直接持股数（股）	期间内股份增减变动量	增减变动原因
庄鼎鼎	董事 副董事长	0	0	0	/
谢景云	董事	0	0	0	/
吴克强	董事 总经理	0	0	0	/
高术峰	独立董事	0	0	0	/
王漪	独立董事	0	0	0	/
陈建惠	独立董事	0	0	0	/
许建笙	独立董事	0	0	0	/
唐慧芬	监事会主席	0	0	0	/
余庆兵	监事	0	0	0	/
陈海英	职工代表监事	18,000	18,000	0	/
李跃松	技术总裁、核心技术人员	0	0	0	/
任新航	董事会秘书、财务总裁	0	0	0	/
合计	/	**73,995,300**	**73,995,300**	**0**	/

注 1：2025 年 7 月，公司董事、总经理吴克强因个人原因离任，且不继续在上市公司及其控股子公司任职；

注 2：公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，自公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第十届监事会监事职务自然免除；

注 3：2025 年 9 月，公司职工代表监事陈海英因个人原因离任，且不继续在上市公司及其控股子公司任职

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司 2025 半年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

于丽华　　吕冠环

中信证券股份有限公司

2025 年 9 月 14 日